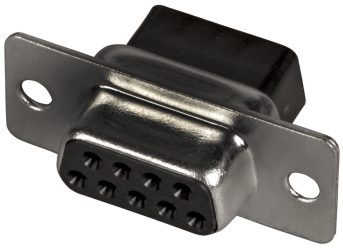
DATENBLATT

DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09



Beschreibung

Das D-Sub Crimpgehäuse 9 polig für Buchsenleisten von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Crimpverbindung ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel, weiblicher Kontaktausführung und der Auslegung für runde Kabel eignet es sich für kompakte und normgerechte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- 9-poliges D-Sub Crimpgehäuse für Buchsenleisten
- 180°-Ausführung mit Crimpanschluss für die Verbindung runder Kabel
- Weibliche Kontaktausführung für eine passende Steckverbindung

Durch den Temperaturbereich von -55 bis 105 °C ist das Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung E-DFCR/09 unterstützt eine stabile Signalverbindung bei industriellen und technischen Applikationen, bei denen eine präzise und dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist.

Technische Details
- Typ: E-DFCR/09
- Anschlussart: Crimp
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Buchse
- Für Kabeltyp: rund
- Kontaktausführung: weiblich (female)
- Polzahl: 9
- Temperaturbereich: -55 – 105 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 50 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Anschlussart	Crimp
Anschusswinkel (180°/90°)	180

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09

Ausführung	Buchse
Für Kabeltyp (rund/flach)	rund
Kontaktausführung	weiblich (female)
Temperaturbereich	-55 – 105

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
34601.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09	9	E-DFCR/09	50 Stück pro Blister	2
34602.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/15	15	E-DFCR/15	50 Stück pro Blister	2
34605.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/50	50	E-DFCR/50	50 Stück pro Blister	3
34601.1V2	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09	9	E-DFCR/09	50 Stück pro Blister	2
34602.1V2	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/15	15	E-DFCR/15	50 Stück pro Blister	2
34603.1V2	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/25	25	E-DFCR/25	50 Stück pro Blister	2
34604.1V2	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/37	37	E-DFCR/37	40 Stück pro Blister	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION